

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2017-006

通富微电子股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员未提出异议；公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为集成电路封装测试。报告期内，公司总体经营情况良好，客户、产品结构不断优化，新产品研发及市场开拓进入收获期，通过并购重组，更加体现出规模效应。2016年全年实现营业收入45.92亿元，同比增长97.75%；归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长22.73%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入	4,591,656,651.56	2,321,903,112.69	97.75%	2,090,685,769.17
归属于上市公司股东的净利润	180,814,573.46	147,325,358.32	22.73%	120,824,422.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,562,604.12	18,601,509.15	472.87%	47,290,142.96
经营活动产生的现金流量净额	784,787,114.32	231,402,755.80	239.14%	415,074,338.01
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%	0.12
加权平均净资产收益率	4.74%	4.50%	0.24%	5.23%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	11,203,124,861.10	6,511,942,944.85	72.04%	3,955,052,997.76
归属于上市公司股东的净资产	3,918,393,476.39	3,740,388,672.42	4.76%	2,364,489,470.95

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	591,529,649.59	1,150,913,655.79	1,466,562,810.90	1,382,650,535.28
归属于上市公司股东的净利润	31,066,208.19	54,422,098.48	38,664,874.58	56,661,392.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,522,296.43	23,083,495.46	35,718,802.50	36,238,009.73
经营活动产生的现金流量净额	93,470,064.25	578,965,548.45	-31,456,355.56	143,807,857.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,929	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,580	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	31.25%	303,967,802	0	质押	86,840,000	
富士通(中国)有限公司	境外法人	21.38%	207,991,680	0			
财富证券—广州农商银行—财富证券星城 10 号集合资产管理计划	其他	2.42%	23,578,558	0			
紫光集团有限公司	境内非国有法人	2.19%	21,339,872	0			

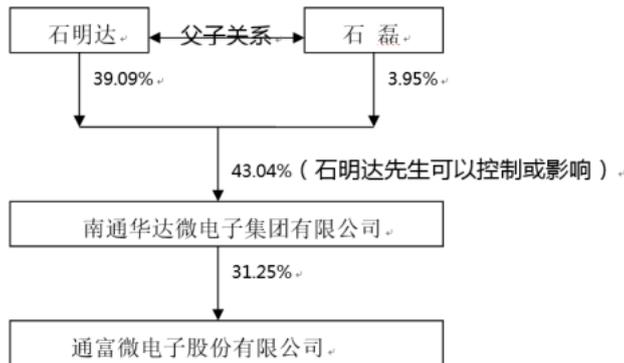
财富证券—浦发银行—财富证券星城 6 号集合资产管理计划	其他	1.62%	15,762,797	0		
山西证券股份有限公司	国有法人	1.03%	10,000,000	0		
华安基金—兴业银行—常州投资集团有限公司	其他	0.49%	4,743,682	0		
财富证券—广州农商行—财富证券星城 8 号集合资产管理计划	其他	0.47%	4,610,270	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.41%	4,000,000	0		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.34%	3,299,925	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：第 1 和第 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 概述

根据SIA统计，2016年全球半导体市场全年总销售值达3,389亿美元，较2015年增长1.1%，其中以中国大陆市场的增幅最大，领跑其它市场。根据中国半导体行业协会统计，2016年中国集成电路产业销售额为4,335.5亿元，同比增长20.1%。其中，设计业继续保持高速增长，销售额为1,644.3亿元，同比增长24.1%；制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动，2016年依然快速增长，同比增长25.1%，销售额1,126.9亿元；封装测试业销售额1,564.3亿元，同比增长13%。

2016年是国家推行“十三五规划”的开局之年，是公司构建“科学布局、集团化协同发展”蓝图至关重要的一年。公司在2016年完成布局，合肥通富、南通通富建成投产，通富超威苏州、通富超威槟城成为公司大家庭的成员，为更好的与晶圆厂、与设计公司合作，承接更多新的订单奠定了基础；公司更名为“通富微电子股份有限公司”，公司开创了集团化、国际化及自主品牌运营的新纪元。2016年，在全体员工的团结拼搏、辛勤努力下，公司初步实现了跨越式发展，各项事业成绩显著。

（一）经营业绩大幅提升，产销利创历史新高

经过多年的“蓄力”，公司为客户服务的能力大幅提高，能够争取并获得更多订单。2016年，未合并通富超威苏州、通富超威槟城的销售收入28.50亿元，同比增长23.68%；合并通富超威苏州、通富超威槟城的销售收入达到45.92亿元，较2015年增长97.75%；全年净利润2.37亿元，同比增长60.67%。

（二）原有业务方面，持续在产品布局、客户渠道和产能规模方面进行了有序而稳健的拓展

1、区域销售格局基本合理。

亚太市场销售额同比增长52%，占销售总额的32.8%；欧美市场销售额同比增长17%，占销售总额的38.7%；国内市场销售额同比增长8%，占销售总额的28.5%。

2、产品销售业绩方面，新老产品全面增长，BGA、FC、WLP等高端产品增速突飞猛进，FC、WLP产品增幅超100%。

3、市场拓展方面，客户结构进一步完善。公司成为华为、展锐正式供应商，获得里程碑式突破；成功导入设计公司中兴微电子，顺利导入三星公司，在2016年销售增长的基础上，进一步加大与MTK的合作力度，全球前10大无晶圆厂IC设计公司，已经有5家成为我们的客户。

4、销售服务能力持续增强。成立了日本和大中华区BD团队；同时在台湾设立了一支拥有技术开发经验的SiP团队，建立了公司SiP业务发展的技术支持平台。

（三）实施跨境并购，协同效应凸显

2016年4月29日，在国家集成电路产业基金支持下，公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权的交割工作，公司与AMD建立战略合作伙伴关系。完成股权交割以来，通富超威苏州、通富超威槟城运行稳中有进，新项目推进有序：

1、AMD订单大幅增加，已导入AMD新产品38个，产量同比2015年增长50%。

2、协同效应初见成效，吸引了Broadcom、Samsung、Socionext等高端客户。槟城工厂顺利量产全球TOP3设计公司产品；苏州工厂顺利量产国内TOP3设计公司产品，赢得第一个AMD以外的新客户，12月已开始第一批量产；苏州工厂和槟城工厂已成功迈出向OSAT转型的第一步。

3、AMD与公司计划启动Bumping合作，加大双方合作及协同效应。

（四）工程建设保障有力，新工厂顺利投产

公司大力推进工程项目建设，适应集团化发展需要。2016年，合肥通富和南通通富顺利通过厂房验收；2016年5月30日，南通通富首台设备进场，9月底成功投产，5个客户转入量产，良率达到99.91%以上；2016年5月30日，合肥通富首台设备进场，已完成20个客户40多个产品的考核，目前合肥通富日均投产已经突破300万，试生产和量产以来，保持了客户重大质量投诉零记录；崇川总部2.5期三楼扩建工程项目2016年3月20日交付使用，新增建筑面积2200m²，净化面积1960m²；通富超威苏州BG改造项目11月份开始实施，涉及建筑面积480m²；通富超威槟城进行了WLCSP小线改造工程，已投入使用，并开展新厂房项目的设计工作，涉及建筑面积19000m²。

(五)技术进步及科技创新硕果累累

1、新产品研发：公司迈入顶尖Power应用产品供应链,IPM200W和电源模组等成功导入并实现大规模量产。

2、工程技术能力提升：开发了20排SOT23和100x300框架尺寸,产品通过了可靠性考核，形成批量生产；成功开发1mil镀钎线、4um厚铝5层Pad的BGA205产品并实现量产；大尺寸QFN成功导入并量产；MEMS产品（陀螺仪）开发成功并小批量生产；完成WLCSP 6面保护的新品开发。

3、知识产权全市企业第一：2016年公司申请专利72件，累计申报专利 645件，累计拥有授权专利297件。公司建立了南通市首家专利专题数据库及南通市首家知识产权专业信息化管理平台；获得“2016年国家知识产权优势企业”荣誉。

4、政府立项项目进展顺利：“02”专项2011年申请的项目顺利通过国家验收；两个市级技术改造专项资金项目通过政府验收。

(六)发行股份购买产业基金持股，推动业务整合

2016年11月，公司向证监会提交了发行股份购买资产并募集配套资金的申请，公司拟以非公开发行A股股票的方式向产业基金购买其所持有的南通富润达49.48%股权、南通通润达47.63%股权。同时，公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过9.69亿元人民币。相关事项已于2017年1月获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

此次发行股份购买资产并配套募集资金顺利实施后，将增强公司对通富超威苏州和通富超威槟城的控股地位和控制力，进一步促进公司对两者的整合。产业基金将成为公司第三大股东，后续借助产业基金的行业影响力，公司的竞争力和行业地位有望持续加强。

(七)公司更名，通富微电品牌建设开启新篇章

公司自上市以来，一直致力于打造属于自己的通富微电品牌，申请注册了“通富微电”商标。经过多年的蓄力与布局，公司更名的时机已经成熟。经公司董事会、股东大会批准，2016年12月2日，经江苏省工商局核准，公司名称变更为：“通富微电子股份有限公司”。从此，公司进入完全依靠自主品牌发展的新纪元。

(八)队伍建设明显增强

2016年，公司引进总监级以上高级技术管理人才7名，引进部级技术管理人才14名（不含通富超威苏州、通富超威槟城及驻外机构）、驻外机构特殊人才9名；继续加大人才储备力度，2016年，招募大学毕业生近400名；引进招募人才的同时，加快现有本土人才的培养，2016年共有227人得到晋升；苏州及槟城团队的加入，给公司注入了具有国际化技术、管理经验的新鲜血液；截至2016年底，公司及主要子公司在职员工总数8,671人，同比增加52.60%。

(九)政府支持与行业影响力不断提高

以“02”、科技、技改、人才等项目为载体，2016年，公司获得各级政府财政共计6,300多万元的资金支持；2016年，公司被评为“江苏省优秀企业”，“江苏百强创新型企业”，“MTK最佳封装质量奖”，“英飞凌最佳供应商”，“2016年昂宝最佳合作伙伴”，“韦尔、集创北方、国民飞骧最佳供应商”。

(2)公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势

1、全球半导体市场发展趋势

存储器和ASSP作为全球半导体市场的重要组成部分，2016年其市场规模为791亿美元和870亿美元，分别占全球半导体市场的23.3%和25.6%，两种产品将成为未来半导体市场增长的主要动力。随着库存的消化，至2016年下半年，存储器价格逐渐升高，市场逐渐呈现增长趋势，预计2017年存储器市场有10%-15%的增长。ASSP是另一个重要的驱动因素，特别是随着物联网和汽车电子市场规模的大幅增长，对ASSP产品的应用需求逐步提升，预计ASSP的增长趋势将持续至2020年左右。据Gartner发布的最新全球半导体行业报告预计，今年全球半导体市场收入将同比增长7.2%，至3,641亿美元。

2、中国半导体市场发展趋势

中国集成电路产业作为中国信息产业的基础行业，过去10的销售收入年复合增长速度达到17.8%，显著高于全球3.6%的复合增速。成为全球为数不多的仍能保持增长的区域市场。国家层面重视目前我国半导体市场自给不足，供需失衡的问题，先后颁布多个政策文件，意在做大做强中国集成电路产业。在《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家集成电路产业投资基金的推动下，中国半导体市场已成为全球增长引擎，2016年中国集成电路产业销售额为4,335.5亿元，同比增长20.1%。在国内设计、制造和封测三业并举、协调发展的格局下，预计2017年国内半导体产业增速区间为18%-25%。

3、国内先进工艺项目将陆续进入建设阶段

根据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）发布的报告，预计将于2017年—2020年间投产的半导体晶圆厂约为62座，其中26座设于中国，占全球总数42%。这些建于我国的晶圆厂2017年预计将有6座上线投产。我们认为相关的产业转移在未

来的中长期将是一个可预期的趋势，将带动产业规模发展，芯片材料、芯片设计与芯片封装领域都将获得实质性的需求提升，将成为我国做大集成电路产业的催化剂。

4、海外合作和国内整合成为新常态

随着综合国力增强和半导体产业快速发展，我国在需求驱动下开始了新一轮半导体发展热潮，中国资本在海外的投资并购活动，已引起美欧日韩等国家的警觉。美国科学技术顾问委员会（PCAST）近期发布报告指出，中国半导体产业的崛起已经对美国构成威胁，并将加强美国外国投资委员会（CFIUS）对中资收购的审查。德国等欧盟国家也强化外商投资审查，特别是中资企业在欧洲的并购。韩国政府支持三星电子和SK海力士领军，筹建总规模2000亿韩元的半导体希望基金，以应对中国存储器产业的崛起。全球半导体产业围绕资本、技术、人才、市场等方面的竞争加剧。面对国际政治和并购环境日趋复杂的局面。

一方面，预计2017年国内资本海外并购态势趋缓，并购难度加大。2016年国内并购总金额同比大幅下降，基本没有对整体公司的并购，都是对国外公司产品线或部分股权的并购，审查受阻案例达到7起。随着全球产业整合和竞争加剧，可供选择的并购标的逐渐减少，国内资本海外并购的难度继续加大。

另一方面，地方集成电路投资持续热度，国内公司和国际公司多形式的合作增多。随着国家集成电路产业基金的设立运行和各项政策的落实，地方政府热情高涨，近两年来北京、武汉、上海、四川等地相继设立集成电路地方基金。预计2017年地方对集成电路产业的投资热度将会持续，各地加快对生产线、产业园和公共服务平台等项目投资，并给以相关政策支持。受国际形势的限制，产业资本将转向国内企业的并购整合，并以平台企业为主打造上下游产业生态。同时由海外并购开始转向多形式的合作，如国际企业与国内企业成立合资公司，在国际巨头整合之后寻找优质产品线溢出的并购机会等。

5、终端应用领域带动行业发展

传统消费电子产品和电脑终端市场已然成熟，且需求正逐渐减弱，但多个新的成长动力已在半导体行业出现，主要包括汽车电子和智能制造领域，将为集成电路企业提供更多市场空间。

全球的汽车电子市场规模伴随着汽车智能化的推进而持续扩大，传统汽车电子应用于动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通信系统等领域，随着在安全、舒适、经济效益等方面的诉求而呈现出持续扩大的局面。另外一方面，新能源汽车的扩张，智能驾驶乃至无人驾驶的愿景使得新的应用领域层出不穷，进一步推动了汽车电子的普及。根据IC Insights的数据预测，2016年全年与汽车电子相关的集成电路产值达到了229亿美元，占整个行业的7.9%，相较于2015年度的209亿美元增长稳健，增速仅次于物联网相关产品，并且预计在未来的5年内仍然能够保持10.3%的增长速度。

智能制造是半导体行业的另一大趋势。未来5至10年，智能制造有望配置数以十亿计的智慧设备，应用到各行各业的智慧工厂，实现工业互联，构成高效互通、协同运转的制造系统。半导体可提供全面的产品阵容，用于智能制造方面的构建模组，具有安全可靠、可扩展的优势，加快智慧工厂的建设进程，快速配置相关生产及制造设备。

除以上的成长机会，电源方案供应商也将持续提供全面的高效能电源和电池管理元件及模组产品，以解决提升功率密度和效能不断成长的需求。这些产品用于各种不同应用，如不间断电源（UPS）、太阳能逆变器和个人电脑电源等。

物联网为代表的智能时代的到来，使得SiP成为趋势。半导体技术发展到今天，28nm的SOC产品是个节点，成本驱动的因素已经消失，而SiP可以弥补缺失的动力，对集成电路产业来讲是非常重要的时间窗口。

从公司现有的产品结构及技术储备看，由智能制造和物联网带来的无线通信模块、电源管理芯片等，以及未来对采用SiP作为先进封装的配套制程的预期，均为公司今后的发展提供了充分的潜力空间。

（二）公司面临的市场竞争格局

在市场竞争格局方面，目前国内集成电路封装测试企业已构成外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中，国际大型半导体企业纷纷在华建厂，无论在规模还是技术水平上占据着一定优势。但同时，我国作为集成电路最大消费国，电子产品最大制造国，在政策鼓励下，晶圆厂的扩张计划和封测厂的并购整合持续推进后，景气的产业环境有利于现有封测厂商提升其产能利用率及市场竞争力。

面对以上竞争格局，公司紧跟市场与客户需求，加快产品、工艺开发与创新：产品结构方面，成功开发出新款BGA产品、超薄QFN产品、eMMC产品、SiP、Bumping、WLCSP、FC等先进封装产品，并购AMD封测资产也体现了公司大力发展先进封装产品的策略和决心。客户结构方面，以市场为导向，及时做好区域客户结构调整优化工作，设计公司产品份额大幅提升。外延并购方面，公司通过收购AMD的封测资产，进入全球领先的集成电路设计厂商的供应链，获得CPU、GPU、APU等芯片封测订单，丰富了公司的产品线，为公司在开拓其他国际一线客户的产品方面提供了更为广阔的空间。随着公司竞争能力的不断增强，公司开拓优质客户的能力也不断提高，为公司收入的增长奠定了坚实的基础。

（三）公司发展战略及规划

1、发展战略

为顺应当前良好的市场环境，公司内部推出三年翻一番的战略目标，并朝着该目标努力奋进。具体包括：公司坚持“服务与创新、进取与和谐”的经营理念，贯彻“顾客满意第一”的经营宗旨，为客户提供“一站式解决方案”；坚持发展主业的指导方针，提升主业盈利能力，采用自身内涵式发展和兼并重组外延式发展相结合的模式，促进公司产品结构调整和转型升级；坚持科技创新的发展理念，引进国内外高层次人才，不断推出满足市场需求、高科技、高附加值的产品，使公司产品技术始终保持国内领先、国际一流水平；坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业文化，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；抓住目前集成电路发展的大好时机，利用国家对集成电路行业的高度重视和强力扶持，积极承担国家科技重大专项等项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得重大突破和创新，努力使公司成为世界级的集成电路高端领域封装测试服务商，在进入全球封测行业前十强后，继续努力使排名不断向前。

2、公司2017年度经营目标

公司计划2017年实现营业收入71.96亿元，较2016年实绩增长56.71%。该生产经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性。

2017年，公司的机遇和优势很多，不确定因素与困难也不少：全球政治环境不确定因素的增加，必然导致外部经济环境的不确定性增多；行业洗牌加剧，价格战短兵相接，企业竞争愈演愈烈。2017年是公司要实现跨越式发展的一年。围绕2017年的生产经营目标，公司将着重做好以下几方面的工作：

一、市场：抢市场、扩销售，促进销售收入大提升

提升公司对设计公司的服务能力，扩大设计公司的市场份额；在增加与现有客户合作的基础上，加大与重点、战略客户的公关与合作；以市场为导向，进一步提高高端产品的占比；进一步研究电源类Power产品的发展规划；加大生物技术，传输（感应）类产品的研发和推进；结合国家发展策略，启动IC-Driver, CPU, 存储类客户推进工作；加快汽车电子新产品的导入；合肥、苏通工厂扩大量产，力争2017年实现盈利。

二、经营：统筹兼顾、健康发展

2017年，是公司集团化管理的优化之年，中心任务是“融合、创新、发展”。公司将继续做好重大专项、募集资金项目建设工作，高度重视安全生产，确保“安全生产无重特重大事故”，实现公司可持续发展；科学地简化系统流程，提升系统运行效率，实现数据化、自动化、无纸化，提升营运效率30%。完善绩效考核与KPI管理，激发各部门的主观能动性和积极性；完善SAP集团一体化财务系统和总部审计的流程化、制度化、信息化，保证公司经营工作的持续平稳健康发展。

三、技术：技术创新，不断提升工艺工程响应能力

技术创新是企业发展的源动力，加快新产品的研发与应用，实现与国内外主要客户的无缝对接，缩短新产品上量周期；重视传统产品，通过技术降本、提高质量，增强产品的竞争优势；加强新产品、新技术以及低成本新材料的研究与应用；加强集团化知识产权管理与平台建设，深入挖掘技术专利布局，做好知识产权/商标/自主品牌的宣传与维护。

四、HR建设：提升人力资源效率

加强优秀应届大学毕业生的储备培养以及急需的高中端技术管理人才的引进工作；完善培训体系，加强工程能力培训；控制人员及人工成本的增长，人工成本占销售收入比重力争与2016年持平；关注员工个人发展，研究完善技术管理人员晋升体制，保持一支优秀的不断壮大的员工队伍，为公司发展助力升级。

3、为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

为保证公司当前业务所需，实现2017年度经营生产目标，完成在建投资项目，并为今后的发展做适当准备，公司及子公司南通通富、合肥通富、通富超威苏州及通富超威槟城计划2017年内在设施建设、生产设备、动力供应方面投资共计21.20亿元，主要用于FCBGA、BGA、QFN、FCCSP、WLP、LQFP、SOT等产品扩产。

苏通工厂已获得1.56亿国家专项建设基金支持；合肥工厂已获得6.6亿国家专项建设基金支持；收购通富超威苏州及通富超威槟城各85%的股份获得国家集成电路产业发展基金2.7亿多美金的支持。2016年10月，公司公告拟通过发行股份购买资产的方式收购国家集成电路产业基金持有的南通富润达投资有限公司49.48%的股权、南通通润达投资有限公司47.63%的股权，同时募集配套资金总额不超过96,900万元，相关事项已于2017年1月获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。此外，公司与合肥政府建立了合作关系，与商业银行及政策性银行均保持长期密切合作，这些支持，为公司技术升级、扩大生产规模、优化产品结构、增强竞争优势，奠定了坚实的资金基础。

（四）公司的风险因素及应对措施

1、行业与市场波动的风险

全球半导体行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，同时，如果产品市场竞争激烈，将会影响产品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业波动给公司带来的经营风险。

2、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险

目前新兴产业、智能产业的发展对集成电路产品的要求也会越来越高。公司通过承担国家“02”专项、收购AMD封测资产，已经取得一定的科研成果，已经具备了提供大规模先进封测的能力。但公司研发的新技术、新工艺、新产品在产业化过程中，如出现一些波折或反复，将给公司生产经营造成一定影响。对此，公司通过引进高层次研发人才、并购高端封测资产，主攻技术含量高、市场需求大的新产品，努力在技术研发层面上少走弯路；公司核心技术骨干和管理力量也将优先服务于新技术、新工艺、新产品，配合客户做好产品认证工作，提前预测产业化过程中有可能出现的问题，做好对策分析工作，缩短客户认证时间，确保新产品如期产业化。

3、原材料供应及价格变动风险

公司封装测试所需主要原材料为引线框架/基板、键合丝和塑封料。公司主要原材料国内均有供应，公司有稳定的供应渠道。但公司外销业务比例较高，境外客户对封装的无铅化和产品质量要求较高，用于高端封装产品的主要原材料必须依赖进口。因此，不排除中国原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，以及因供货商供货不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，或者境外原材料市场发生变化，影响公司的产品产量和质量，对公司经营业绩产生一定影响。

4、外汇风险

2014年、2015年及2016年，公司出口销售收入占比分别为73.07%、71.49%、84.44%，外销收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生

一定影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路封装测试	4,585,908,602.43	141,324,292.16	17.96%	98.51%	833.48%	-3.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，因合并了AMD苏州及AMD槟城营业收入、成本、利润，以及原有业务营业收入、成本、利润增长，使得公司报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

受影响的报表项目	影响金额
税金及附加	9,236,881.17
管理费用	-9,236,881.17

报告期内，公司不存在重要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度新纳入财务报表合并范围的子（孙）公司主要包括非同一控制下企业合并取得的通富超威苏州、通富超威槟城。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2017 年 03 月 16 日